

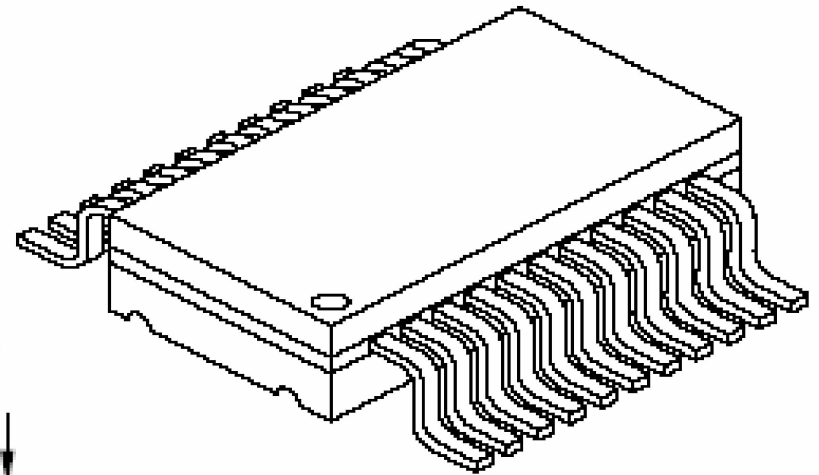
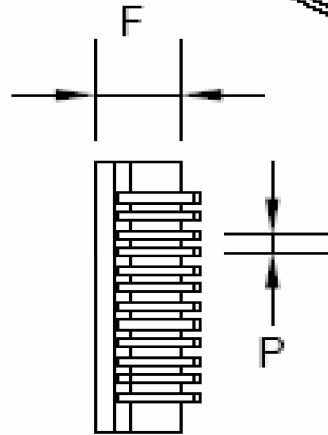
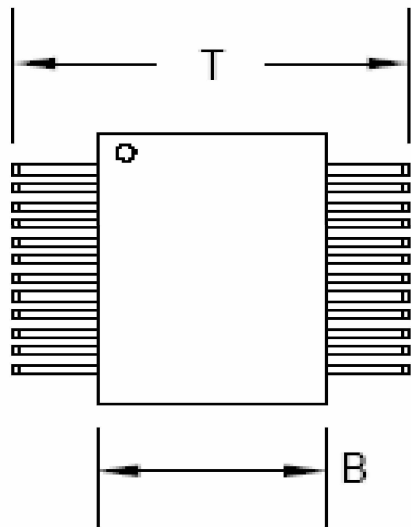
SOIC (Small Outline IC)

- Pierwsze obudowy do montażu powierzchniowego (ekwiwalent DIP)
- Pierwsze obudowy miały odstęp między pinami 0.05"
- Występuje wiele wariacji obudów SOIC nazywanych: SSOP, TSOP, TSSOP itd. o mniejszym odstępem między pinami.



Nazwa	Liczba pinów	Odstęp między pinami [mm]	Opis
SOP	8, 16, 24, 28, 32, 40, 44	1.27	
SSOP	20, 28, 30, 32, 60, 64, 70	0.65, 0.80, 0.95, 1.00	Obudowa odporna na temp.
TSOP(1)	32, 48	0.50	Piny na krótszej stronie
TSOP(2)	26(20), 26(24), 28, 28(24), 32, 44, 44(40), 48, 50, 50(44), 54, 66, 70(64), 70, 86	0.50, 0.65, 0.80, 1.27	Piny na dłuższej stronie obudowy

SOIC - wygląd



P - odstęp między pinami

B - szerokość obudowy

F - Wysokość obudowy